

Manufacturing



Manual electroless Ni-Pd-Au
plating equipment

リジット基板・フレキシブル基板

無電解 Ni-Pd-Au めっき

～特徴～

無電解 Ni-Au 厚付けめっき製品の代替皮膜としてリジット基板・FPC 等の製品に処理が可能です。

半田付け性、ボンディング性は電解ボンディング(軟質)Au めっきと同等レベルを実現しております。(下図にて御比較下さい)
無電解 Ni-Au 厚付けめっきの VE をご検討の場合は是非ともご検討下さい。

項目	電解 Ni-Au	無電解 Ni-厚 Au	無電解 Ni-Pd-Au
高密度化	△	◎	◎
膜厚均一性	×	◎	◎
W/B 性	◎	○	◎
加熱後 W/B 性	◎	×	◎
半田接合強度	◎	×	◎

～生産能力～

◎対応製品サイズ
サイズ (MAX) 510×510mm 約 3,000 m²/Month

◎対応めっき仕様
無電解 Ni めっき 0.50～7.00 μm (P 濃度 6.0±1.0%)
無電解 Pd めっき 0.05～0.25 μm (Pd-P 濃度 7.0±1.0%)
無電解 Au めっき 0.03～0.20 μm

- ◆ファインパターン対応の無電解 Ni-P 浴
- ◆膜厚均一性に優れています。

◇無電解 Ni-Pd-Au めっき浴は汚染に非常に弱く、量産前に溶出テスト等の実施をお勧めしております。